

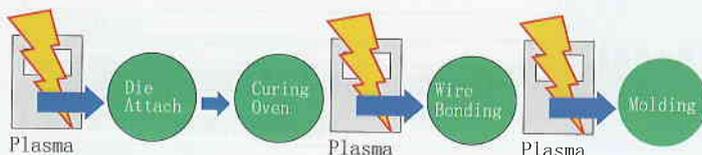
■ 双周波等离子清洗机 DSU-1600 采用2周波等离子方式, IC Magazine可以直接放入进行处理。



■ 特征

在真空室内单独或混合注入Ar/O₂气体, 加上RF电压, 产生高密度的Ar(O₂)离子, 再通过LF电力给与高运动能。可以以Magazine为单位, 对BGA基板等进行等离子清洗。

用途 (IC封装工程)



■ 技术规格

反应气体系统	聚合控制器2系统
整合器	自动
电极尺寸	宽200X前后深225mm
高度 (可以定制)	高150mm(可以定制)
电源	三相AC200V 40A (可380V对应)
外形尺寸	宽900X前后深850X高1650mm



IC BGA基板干式清洗



1. 电路板IC芯片放入前的清洗



2. Wire Bonding前的清洗



3. Molding前的清洗

IC BGA Mold评价



良品



不良品

■ 大气压等离子清洗机 YAP510

■ 概要

能够在大气压开放状态下进行等离子处理, 所以在燃料电池和医疗领域有广泛的用处。电极部采用Yamato专利的特殊大面积构造, 能够大批量快速在线处理。

■ 用途

- 利用等离子活性去除有机物和氧化物
- 高分子材料的表面处理
- FPD关联玻璃基板清洗
- 灰化处理
- 表面清洗(氧化还原)

■ 技术规格

处理对向尺寸	~300X300mm(定制规格)
频率	高频电源 或 低频电源
输出功率	500W
气体	3系统 可以从Ar/He/O ₂ /N ₂ /H ₂ 中选择 流量: 1~10L/min
电源	3相200V 15A 排气口: φ100
标准尺寸	730(W)X750(D)X1700(H)mm (定制规格)
控制方式	PLC、触摸屏



YAP510

处理带宽600mm

